道康宁展示创新的硅基保温隔热解决方案

有机硅、硅基技术和创新领域的全球领导者道康宁公司，今天在北京召开的“第七届国际绿色建筑与建筑节能大会”上，展示了创新的建筑墙面保温隔热解决方案。

道康宁高效的中空保温隔热板(VIP)系统与传统隔热材料相比，能将热传导率降低五到十倍，提升商用建筑和民用住宅的能效、耐久性和可持续性。

当今世界，全球气候变化日趋两极化，全世界都面临着建造低碳、环保与绿色城市的艰巨挑战。由于建筑物的运营能耗占所有能源消耗的很大一部分，这促使多国政府不断强调建造“绿色建筑”的重要性。

研究表明，更高效的保温隔热措施能够为建筑节约60%的能耗。道康宁建筑工业全球市场总监贺德凯(JeanPaul Hautekeer)指出，道康宁的隔热产品在实现全球节能方面发挥着至关重要的作用。

贺德凯表示：“道康宁在建筑行业的专业经验与有机硅技术的完美结合，是创造可靠的建筑隔热系统的关键。这样的建筑系统能够提供绝佳的保温性与耐用性，有助于降低能耗和建筑物总体成本。”

随着建筑隔热标准的不断提高，如果没有更加有效的保温隔热方案，建筑外墙必然会越来越厚、越来越复杂，建筑成本也会大大增加。道康宁正在研制的可应用于建筑物的中空保温隔热板(VIP)系统，不仅能够提供最佳的空间/性能比，更比传统隔热材料的导热性低五到十倍。

贺德凯补充道：“高性能、可持续性、轻质、防火性、空间、生命周期，这些都是未来隔热技术需要考虑的关键因素。未来几年里，我们将见证更多的技术变革，这远比我们在过去几十年里目睹的还要多。长期以来，道康宁一直致力于满足中国客户对于绿色建筑的需求。”

国际绿色建筑与建筑节能大会始于2005年，之后每年召开一次，由中国住房和城乡建设部主办。会议每年吸引超过2000名与会者，包括来自中国、英国、美国、法国、加拿大、德国等国家和地区的城市市长、政府代表、绿色建筑理事会代表、业内专家、制造商、经营者与房产商等社会各界人士。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/23330.html